

PCB训练2

题量: 12 满分: 71.0

考试时间: 2021-12-20 08:07 至 2022-01-10 19:54

智能分析

作答记录

本次成绩 71.0 分

最终成绩 71.0 分

一. 单选题 (9.0分)

1

2

3

二. 多选题 (42.0分)

4

5

6

9

10

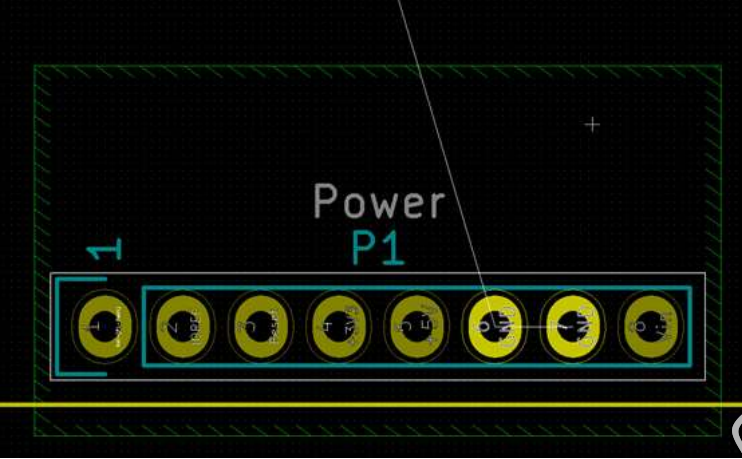
三. 连线题 (20.0分)

11

12

一. 单选题 (共3 题, 9.0分)

1. (单选题,3.0分)底层铺设GND铜皮时, 出现以下情况是“首选项” 选择了什么模式下绘制造成?



- A.

	传统工具箱 (S)	F9
	现代工具箱 (硬件加速 A)	F11
	现代工具箱 (软件加速 K)	F12
- B.

	传统工具箱 (S)	F9
	现代工具箱 (硬件加速 A)	F11
	现代工具箱 (软件加速 K)	F12
- C.

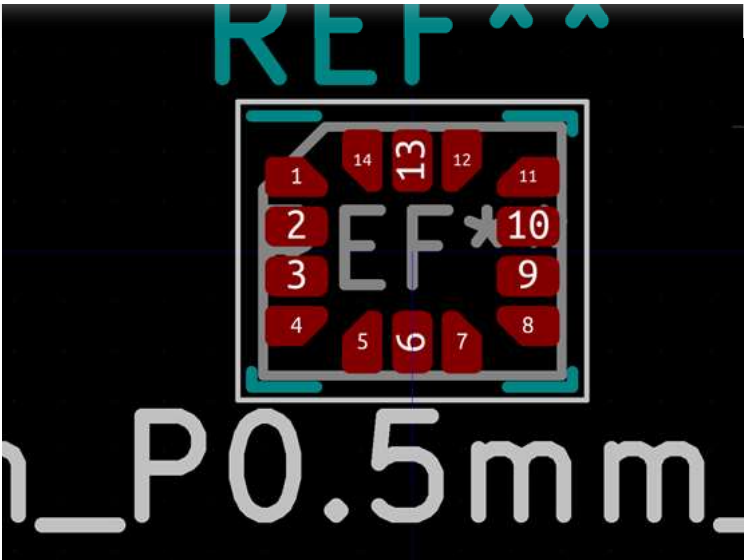
	传统工具箱 (S)	F9
	现代工具箱 (硬件加速 A)	F11
	现代工具箱 (软件加速 K)	F12

我的答案:C

正确答案:C

3.0 分

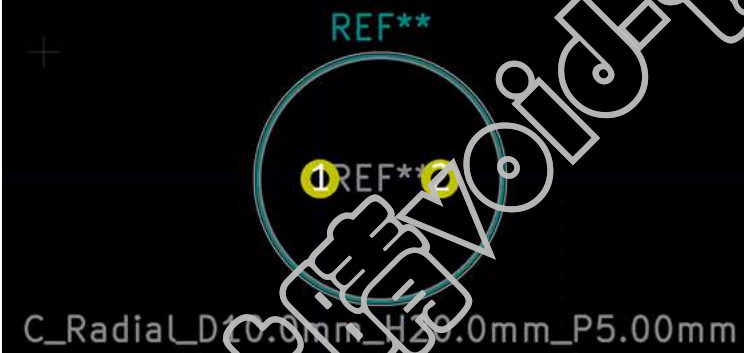
2. (单选题,3.0分)打开如图LGA-14_3x2.5mm_P0.5mm_LayoutBorder3x4y封装, 描述恰当的有:



- A. 焊盘属性里可以自定义焊盘形状
- B. 引脚5焊盘形状是自定义异形
- C. 引脚12焊盘形状是圆角矩形
- D. 编辑图元时只能修改基本形状多边形拐点位置
- E. 编辑自定义形状时，需要编辑图元

我的答案: E 正确答案: E 3.0 分

3. (单选题, 3.0分) 打开下图封装，元件封装上最外侧边界属于哪层：



- A. Edge.Cuts
- B. F.CrtYd
- C. F.Mask
- D. B.CrtYd

我的答案: B 正确答案: B 3.0 分

二. 多选题 (共7 题, 42.0分)

1. (多选题, 6.0分) 根据下图，同一元件的元件符号和封装的说法恰当的有：

一. 单选题 (9.0分)

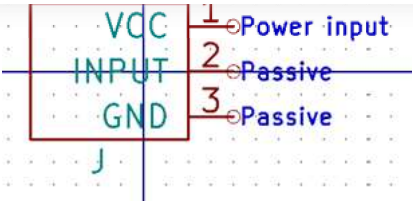
- 1
- 2
- 3

二. 多选题 (42.0分)

- 4
- 5
- 6
- 9
- 10

三. 连线题 (20.0分)

- 11
- 12



- A. 方向向左的引脚数量为3
- B. 默认位号为J
- C. 方向向右的引脚数量为3
- D. 元件引脚数量为3，Power引脚的编号为1
- E. 元件名为mycoonn3
- F. 电气类型为被动的引脚编号为2和3

我的答案: ABF 正确答案: ABF

6.0 分

一. 单选题 (9.0分)

- 1 2 3

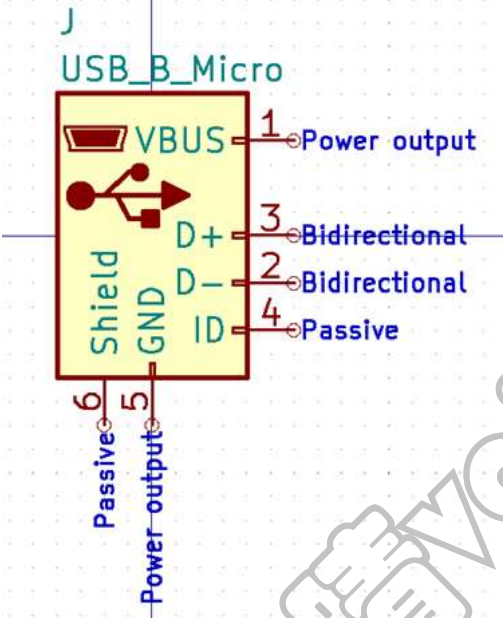
二. 多选题 (42.0分)

- 4 5 6
- 9 10

三. 连线题 (20.0分)

- 11 12

2. (多选题,6.0分)打开符号库中的如图元件，描述恰当的有：



- A. 矩形外框填充的是主体背景颜色
- B. 矩形外框高大于15mm
- C. 圆形填充的是主体背景颜色
- D. 矩形外框宽大于500mil
- E. 圆形填充的是主体轮廓颜色

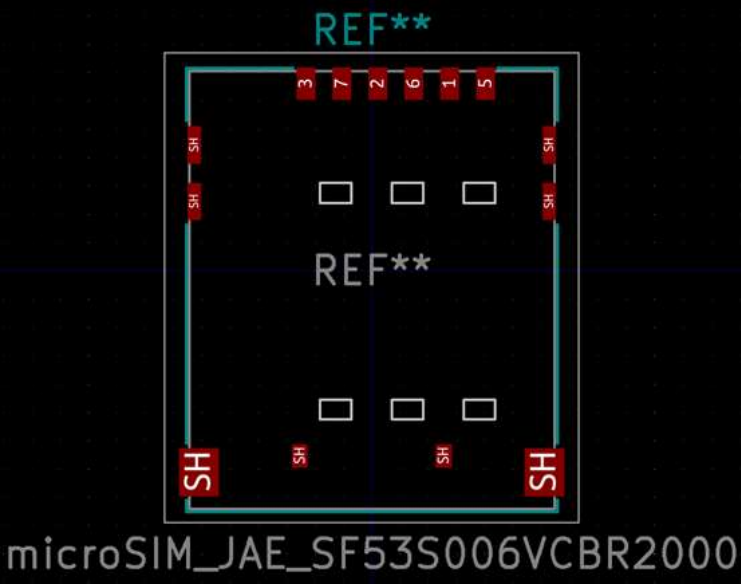
我的答案: ABE 正确答案: ABE

6.0 分

3. (多选题,6.0分)请选择合适的符号名称和符号库昵称：

- A. PIC 12
- B. PIC_12
- C. ./swtich
- D. myconn3
- E. :led:

4. (多选题,6.0分)打开如图microSIM封装, 使用“相对位置”工具移动左下角SH焊盘位置, 描述恰当的有:

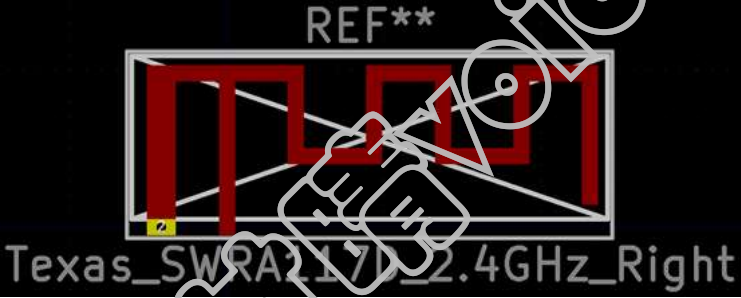


- A. 往下平移0.05in, 输入偏移Y为-0.05in
- B. 参考点可以是其他焊盘边界
- C. 往左平移0.06in, 输入偏移X为-0.06
- D. 参考点可以是蓝色十字轴心

我的答案:BCD 正确答案: BCD

6.0 分

5. (多选题,6.0分)打开如图2.4GHz封装, 描述恰当的有:

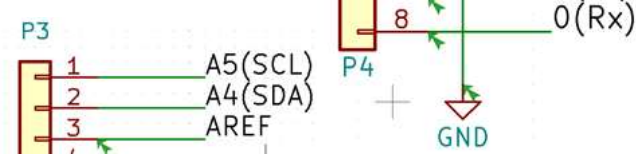


- A. 细线宽约0.5mm
- B. 最粗线宽约0.9mm
- C. 元件高0.18in
- D. 引脚2焊盘在F.cu层
- E. 这是一种2.4G天线封装

我的答案:ABE 正确答案: ABE

6.0 分

6. (多选题,6.0分)绘制好原理图后执行电气规则检查警告, 描述正确的有:



- A. 存在引脚未连接

一. 单选题 (9.0分)


- 1
- 2
- 3

二. 多选题 (42.0分)

- 4
- 5
- 6
- 9
- 10

三. 连线题 (20.0分)

- 11
- 12

- C. 存在引脚连接到其他一些引脚但没有引脚来驱动它
- D. 使用  标记未驱动的引脚

我的答案:AC 正确答案: AC

6.0 分

7. (多选题,6.0分)打开如图BGA-25_6.35封装,使用“精确移动”工具移动D2号焊盘位置到B5位置,描述恰当的有:



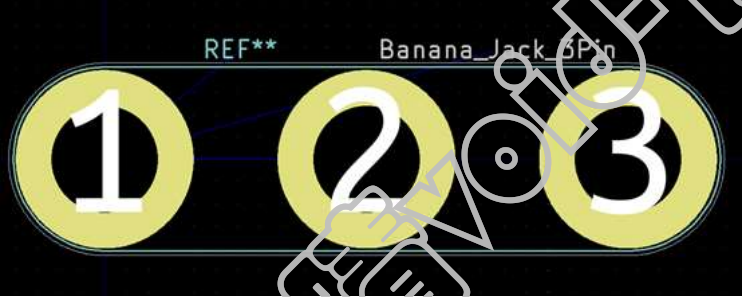
- A. 移动X: 输入2.54mm
- B. 移动Y: 输入-1.27-1.27mm
- C. 移动Y: 输入-1.27mm
- D. 移动X: 输入3.81mm

我的答案:BD 正确答案: BD

6.0 分

三. 连线题 (共2 题, 20.0分)

1. (连线题,10.0分)打开以下封装, 请连接恰当焊盘属性:



第1组

1. 焊盘编号
2. 焊盘类型
3. 焊盘形状状态
4. 工艺层
5. X尺寸
6. 钻孔尺寸
7. 位号字符

第2组

- A. 1或2或3
- B. 通孔
- C. 圆形
- D. F.MASK和B.MASK
- E. 10.16mm
- F. 6.1mm
- G. REF**

我的答案: 正确答案:

1 — A 1 — A

2 — B 2 — B

3 — C 3 — C

4 — D 4 — D

5 — E 5 — E

6 — F 6 — F

7 — G 7 — G

10.0 分

2. (连线题,10.0分)符号编辑器中, 请连接恰当的引脚属性。

一. 单选题 (9.0分)

- 1 2 3

二. 多选题 (42.0分)

- 4 5 6
- 9 10

三. 连线题 (20.0分)

- 11 12

考试详情

- 1. 电气类型 
- 2. 电气类型 
- 3. 电气类型 
- 4. 图形样式 
- 5. 图形样式 
- 6. 图形样式 
- 7. 方向 

- A. Power input
- B. Bidirectional
- C. Output
- D. 线
- E. 反相
- F. 反相时钟
- G. 向上

一. 单选题 (9.0分)

- 1
- 2
- 3

二. 多选题 (42.0分)

- 4
- 5
- 6
- 9
- 10

三. 连线题 (20.0分)

- 11
- 12

我的答案:

正确答案:

10.0 分

- 1 — A

2 — B

3 — C

4 — D

5 — E

6 — F

7 — G
- 1 — A

2 — B

3 — C

4 — D

5 — E

6 — F

7 — G